

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）64.69%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司董事会经审慎分析，认为本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市，具体说明如下：

一、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司、标的公司经审计的 2025 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易额孰高	资产净额与交易额孰高	营业收入
收购杭州众硅 10.21%股权	23,534.88	23,534.88	-
本次交易	157,604.91	157,604.91	24,411.88
累计金额	181,139.79	181,139.79	24,411.88
项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司交易前一年（2025 年）财务数据	2,984,601.90	2,272,884.05	1,238,463.83
占比	6.07%	7.97%	1.97%

注：累计计算本次交易前十二个月内，曾发生购买同一资产的情况。

根据上述计算结果，本次交易资产总额、资产净额、营业收入指标均未超过 50%，按照《重组管理办法》第 12 条的规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、本次交易不构成关联交易

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次交

易完成后，无单一交易对方或同一控制下交易对方合计持有上市公司股份超过5%。因此，根据《股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月30日